

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年11月17日 (17.11.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/108496 A1

- (51) 国際特許分類: C08L 83/07, 83/05
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/008490
(22) 国際出願日: 2005年5月10日 (10.05.2005)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2004-142607 2004年5月12日 (12.05.2004) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭電化工業株式会社 (ASAHI DENKA CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1160012 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 Tokyo (JP). 関西電力株式会社 (THE KANSAI ELECTRIC POWER COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒5308270 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号 Osaka (JP).

(SUEYOSHI, Takashi) [JP/JP]; 〒1160012 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式会社内 Tokyo (JP). 日渡 謙一郎 (HIWATARI, Ken-ichiro) [JP/JP]; 〒1160012 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式会社内 Tokyo (JP). 謝名堂正 (JANADO, Tadashi) [JP/JP]; 〒1160012 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式会社内 Tokyo (JP). 東海林 義和 (SHOJI, Yoshikazu) [JP/JP]; 〒1160012 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式会社内 Tokyo (JP). 菅原 良孝 (SUGAWARA, Yoshitaka) [JP/JP]; 〒5308270 大阪府大阪市北区中之島3丁目3番22号 関西電力株式会社内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 羽鳥 修 (HATORI, Osamu); 〒1070052 東京都港区赤坂一丁目8番6号 赤坂 HKNビル 6階 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 末吉 孝

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

[続葉有]

(54) Title: SILICON-CONTAINING CURABLE COMPOSITION AND CURED OBJECT OBTAINED BY THERMALLY CURING THE SAME

(54) 発明の名称: ケイ素含有硬化性組成物、及びこれを熱硬化させた硬化物

(57) Abstract: A curable composition which comprises at least one of the following (A), (B), and (C) and further contains the following (D) (provided that when (C) is not contained, both (A) and (B) are contained). (A): A silicon-containing polymer in which the content of components having a weight-average molecular weight of 1,000 or lower is 20 wt.% or lower and which has a reactive group A' and one or more Si-O-Si bonds. (B): A silicon-containing polymer in which the content of components having a weight-average molecular weight of 1,000 or lower is 20 wt.% or lower and which has an Si-H group and one or more Si-O-Si bonds. (C): A silicon-containing polymer in which the content of components having a weight-average molecular weight of 1,000 or lower is 20 wt.% or lower and which has a reactive group A', an Si-H group, and one or more Si-O-Si bonds. (D): A catalyst for curing reaction which is a platinum catalyst. The reactive group A' is any of Si-R¹, Si-O-R², and Si-R³-OCOC(R⁴)=CH₂, provided that R¹ and R² each is alkenyl, R³ is alkylene and/or arylene, and R⁴ is hydrogen or methyl.

(57) 要約:

下記(A), (B), (C)の何れか一つ以上と(D)とを含む硬化性組成物。
(ただし(C)を含有しない場合は(A), (B)両方を含む)

- (A): 反応基A'を有し、Si-O-Si結合を一つ以上有する、重量平均分子量1000以下の成分が20重量%以下のケイ素含有重合体
(B): Si-H基を有し、Si-O-Si結合を一つ以上有する、重量平均分子量1000以下の成分が20重量%以下のケイ素含有重合体
(C): 反応基A'とSi-H基を有し、Si-O-Si結合を一つ以上有する、重量平均分子量1000以下の成分が20重量%以下のケイ素含有重合体
(D): 白金系触媒である硬化反応触媒
反応基A'とは、Si-R¹、Si-O-R²、Si-R³-OCOC(R⁴)=CH₂の何れかであり、R¹, R²はアルケニル基、R³はアルキレン基及び/又はアリーレン基、R⁴は水素又はメチル基である。

WO 2005/108496 A1



BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。